

株式会社 アルバック

2025年6月期 第2四半期
決算説明資料

2024年7月～2024年12月

2025年2月12日



将来見通し等に関する記述についての注意事項

■ 将来見通しについて

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おさください。

■ 数字の処理について

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

■ 品目名称変更について

2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

- 上期の売上高・各利益項目は、計画比・前年同期比を上回る増収増益で着地
受注高は前年同期比で減少も、下期は上期比増加を見込む
- 利益率のベースが着実に上昇、2Q売上総利益 238億円は四半期ベースで
上場来最高水準
- 通期受注高を見直すも、売上高・各利益項目の連結業績予想に変更なし
⇒ 市場環境・投資動向トレンドを確実に捉え、全体の受注拡大を目指す

・上期決算サマリー

ポイントは大きく3つとなります。

① 上期の着地について

売上高・各利益項目は、前年同期比及び計画比を上回り増収増益となりました。受注高につきましては、前年同期比で減少となりましたが、下期は増加を見込んでおります。

② 利益率に関して

中期経営計画の基本方針として注力しており、この上期においても、利益率のベースは着実に上昇しております。なお、2Qの売上総利益238億円は四半期ベースでの上場来最高水準となっております。

③ 通期の見通しについて

受注高のみ足元の状況を反映して見直しましたが、通期の業績予想につきましては、変更なく据え置いております。

引き続き、市場環境・投資動向のトレンドを確実に捉え、全体の受注拡大を目指してまいります。

【単位：億円】	2024/6期						2025/6期					
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	上期計画	上期実績	前年同期比	
受注高	780	561	1,340	556	685	2,582	509	655	1,340	1,164	-176	-13%
売上高	550	652	1,202	650	759	2,611	610	739	1,290	1,349	+147	+12%
売上総利益	153	201	354	220	233	807	191	238	-	429	+75	+21%
率	27.7%	30.8%	29.4%	33.8%	30.7%	30.9%	31.3%	32.2%	-	31.8%	+2.4pt	
販管費	124	126	250	119	139	509	134	142	-	276	+26	+10%
営業利益	28	75	103	101	94	298	58	96	140	153	+50	+49%
率	5.1%	11.5%	8.6%	15.5%	12.3%	11.4%	9.4%	13.0%	10.9%	11.4%	+2.8pt	
経常利益	29	81	110	95	93	298	69	92	140	161	+51	+46%
率	5.3%	12.4%	9.1%	14.6%	12.3%	11.4%	11.3%	12.4%	10.9%	11.9%	+2.8pt	
親会社株主に帰属する 当期純利益	11	57	69	64	69	202	37	67	90	104	+35	+51%
率	2.1%	8.8%	5.7%	9.9%	9.1%	7.7%	6.1%	9.0%	7.0%	7.7%	+2.0pt	

- › YoY増収増益を達成、売上総利益率は 31.8% と着実に上昇
- › 1Q比で2Qは全ての項目で改善

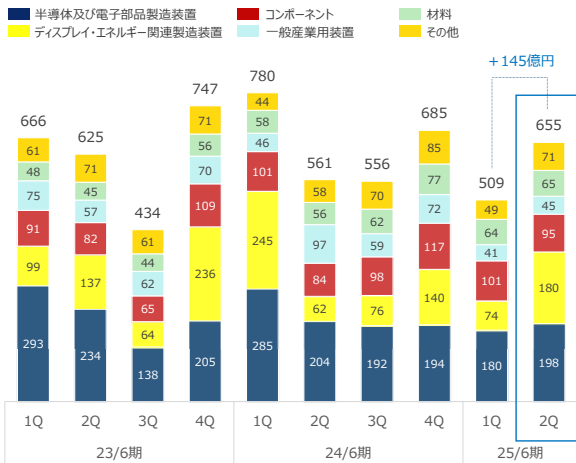
・上期決算の概要

青枠の実績の通り、前年同期比では受注高が減少となりましたが、売上高・各利益項目については、売上総利益率が31.8%と着実に上昇するなど、概ね計画通りの進捗となり、増収増益を達成しております。

1Q比で2Qは全ての項目で改善しております。

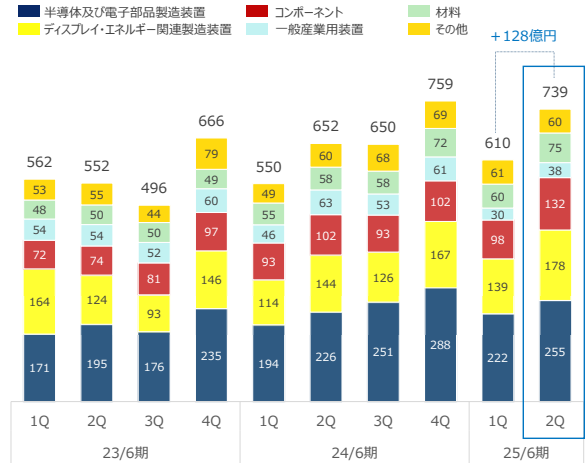
受注高

【単位：億円】



売上高

【単位：億円】



- ▶ 【受注高】 1Q比+145億円：OLED（G8.7）案件受注、その他（表面分析装置）等が増加
- ▶ 【売上高】 1Q比+128億円：高水準の受注残高が寄与し、総じて品目毎に増加

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

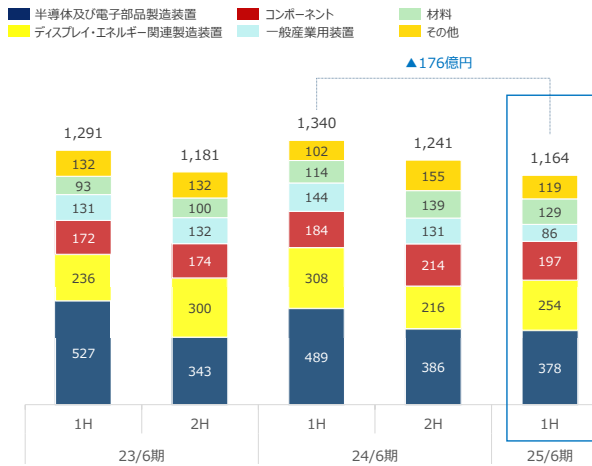
・四半期推移の状況

2Qの受注高は655億円と、1Q比で145億円のプラスとなりました。大きくはOLED投資の本格化もあり、ディスプレイ・エネルギー関連が100億円強の増加となったほか、その他品目の「表面分析装置」が好調だったことです。

売上高においては、高水準の受注残高が寄与するなど、総じて品目毎に増加しており、1Q比プラス128億円となりました。

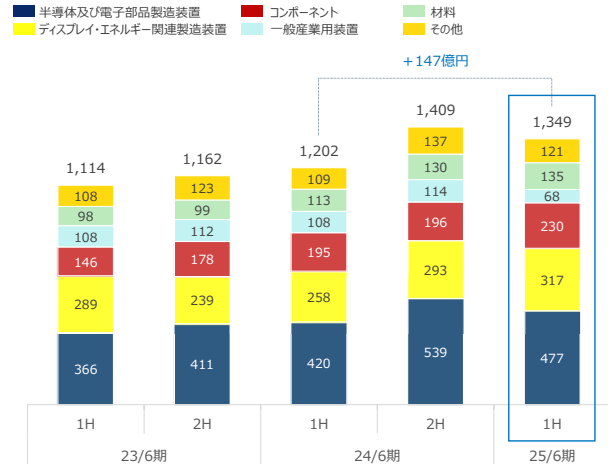
受注高

【単位：億円】



売上高

【単位：億円】



- ▶ 【受注高】 前1H比 ▲176億円：パワーデバイス・バッテリー等の反動減で減少
- ▶ 【売上高】 前1H比 +147億円：売上計上が着実に進み、総じて各品目毎に増加

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

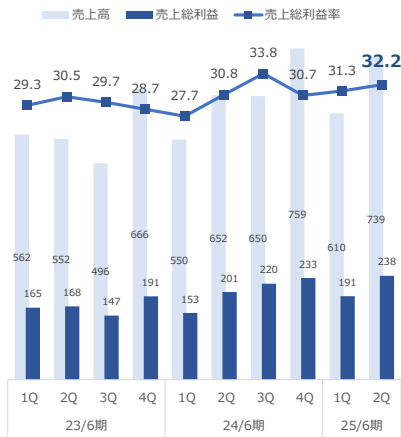
・上半期の状況

受注高においては、前上期にパワーデバイス・バッテリーの集中投資があった関係で、その反動減もあり、前期比176億円のマイナスとなりました。

一方で、売上高については、受注からの売上計上が着実に進むなど、前上期比147億円のプラスと増収での着地となっております。

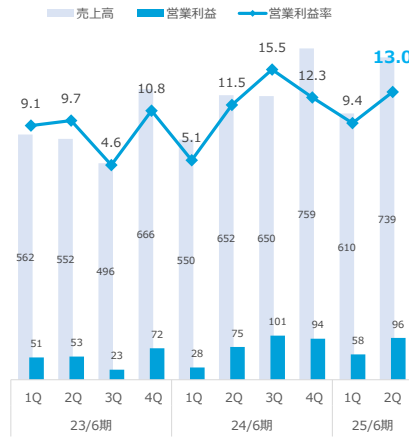
売上総利益率

【単位：億円、%】



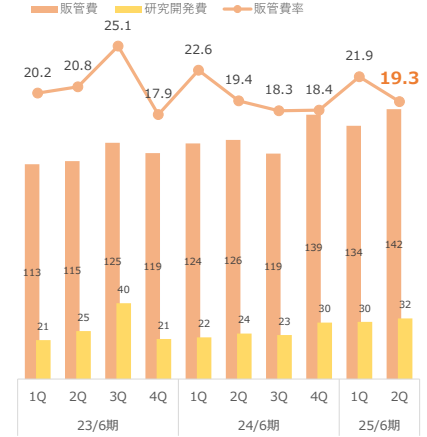
営業利益率

【単位：億円、%】



販管費率

【単位：億円、%】



- » 売上総利益率：1Q比増収効果に加え、利益率の高い半導体電子・コンポーネントの売上高構成比は50%超を継続し、利益率のベースは着実に上昇
- » 営業利益率：増収効果等で1Q比3.6pt改善

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

7

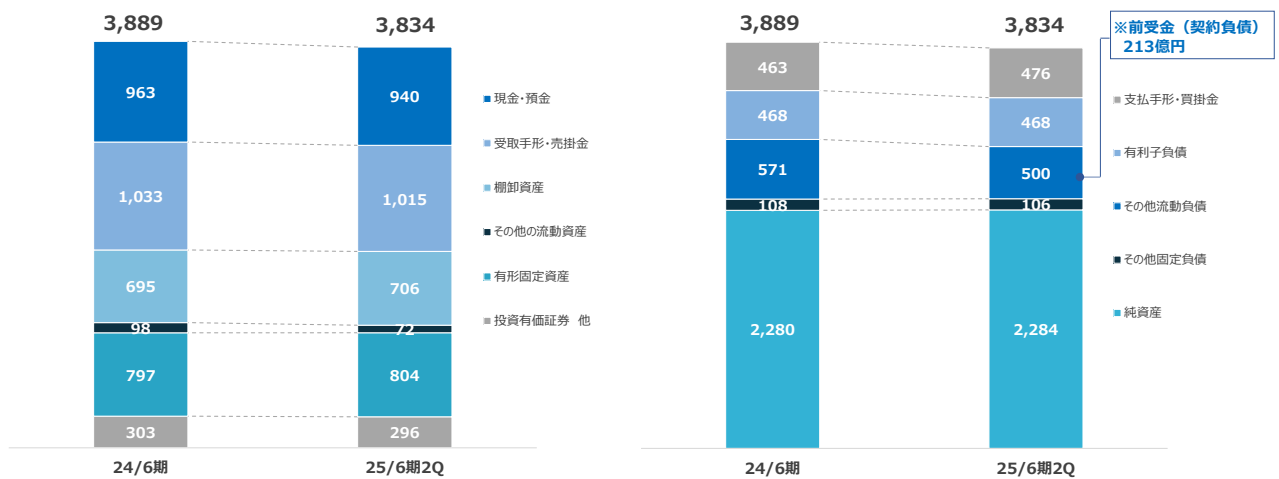
・利益率の推移

2Qの売上総利益率は32.2%となり、1Q比で0.9ポイント改善しました。1Qからの増収効果に加えて、品目別の中でも利益率の高い「半導体電子・コンポーネント」の構成比が50%超を継続するなど、利益率のベースは着実に上昇しており、引き続きマージン改善が図れております。

営業利益率においても、増収効果等で、1Q比で3.6ポイント改善し13.0%となりました。

資産 [単位：億円]

負債・純資産 [単位：億円]



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

・2Q末のバランスシートの状況

総資産は、前期末に比べ55億円減少し、3,834億円となっております。

【単位：億円】	24/6期			25/6期		
	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	前年同期比	
					増減額	増減率
受注高	2,582	1,164	1,436	前回※ 2,700 今回 2,600	+118	+5%
売上高	2,611	1,349	1,401	2,750	+139	+5%
営業利益	298	153	192	345	+47	+16%
率	11.4%	11.4%	13.7%	12.5%	+1.1pt	-
経常利益	298	161	189	350	+52	+18%
率	11.4%	11.9%	13.5%	12.7%	+1.3pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	104	126	230	+28	+14%
率	7.7%	7.7%	9.0%	8.4%	+0.6pt	-
1株あたり配当金（円）	144			164	+20	

半導体電子部品
・パワーデバイス ▲60
ディスプレイ・エネルギー
・バッテリー ▲20
一般産業
・高機能磁石製造装置等 ▲20

※2024/8/13公表値

- ≫ 受注高：EV需要鈍化等を反映し、受注高見込みを2,600億円に見直し
- ≫ 売上高・各利益(率)：受注残高(2Q末1,255億円)の寄与等もあり、業績予想は据え置き

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

9

・通期の見直し

期首に想定していた以上にEV需要が鈍化していることなど、投資が減速している現状を反映し、受注高の見直しを、期首の2,700億円より100億円下げ、2,600億円へと見直しました。

内訳につきましては、期首想定より、パワーデバイスで60億円、バッテリーで20億円、高機能磁石製造装置等で20億円、受注高の見直しを見直しました。

通期業績予想については、2Q末時点の受注残高1,255億円の寄与等が十分に見込めることもあり、業績予想は据え置いております。



事業環境と今後の展開

品目	市場環境・投資動向	CY25	CY26
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none"> DRAM：生成AI需要拡大により投資加速 NAND：在庫調整が進捗し投資再開 先端ロジック：次世代ノードに向けた投資本格化 		
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> 生成AI需要拡大により先端パッケージングビジネス活発化 技術革新・増産投資継続 		
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> 足元はEV需要鈍化により投資減速も中長期に成長 		
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ITパネル用OLED（G8.7）投資活発化 LCD、OLED（G6）高精細化に向けた設備追加・改造案件寄与 		
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none"> 次世代バッテリーの車載への採用タイミングが遅延傾向も中長期的に成長 		
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none"> 半導体関連投資の回復等で安定基盤ビジネスとして堅調に推移 AIサーバー冷却システム等、新規用途のリークテスト装置拡大期待 先端デバイス等の研究開発活発化に伴う表面分析装置好調 		

» 市場環境・投資動向トレンドを確実に捉え、全体の受注拡大を目指す

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

11

●市場環境及び投資動向について

●半導体メモリ・ロジック

DRAMは、生成AI需要の拡大に伴い、引き続き投資は加速すると見込まれ、NANDにおいても、在庫の調整が進んでいることから、段階的な投資再開が期待されます。ロジックについては、次世代ノード向けの投資が本格化してきていると感じており、半導体全体として、プラス成長が続くと見込んでおります。

●各種電子デバイス

先端パッケージングがDRAM同様に生成AI需要拡大と併せて活況であり、受注拡大が見込まれます。

●パワーデバイス

中長期的な成長は見込まれますが、EV需要が鈍化している影響もあって、各社の投資計画が1年程度ずれ込んでいることから、本格的な投資の再開は、27年6月期以降になると見込んでおります。

●ディスプレイ

ITパネル用のG8.7 OLEDの投資が活発化していることに加え、さらに中国において、補助金の適用もあり、LCDやG6 OLED設備追加や改造案件の増加が寄与してくる見通しであります。

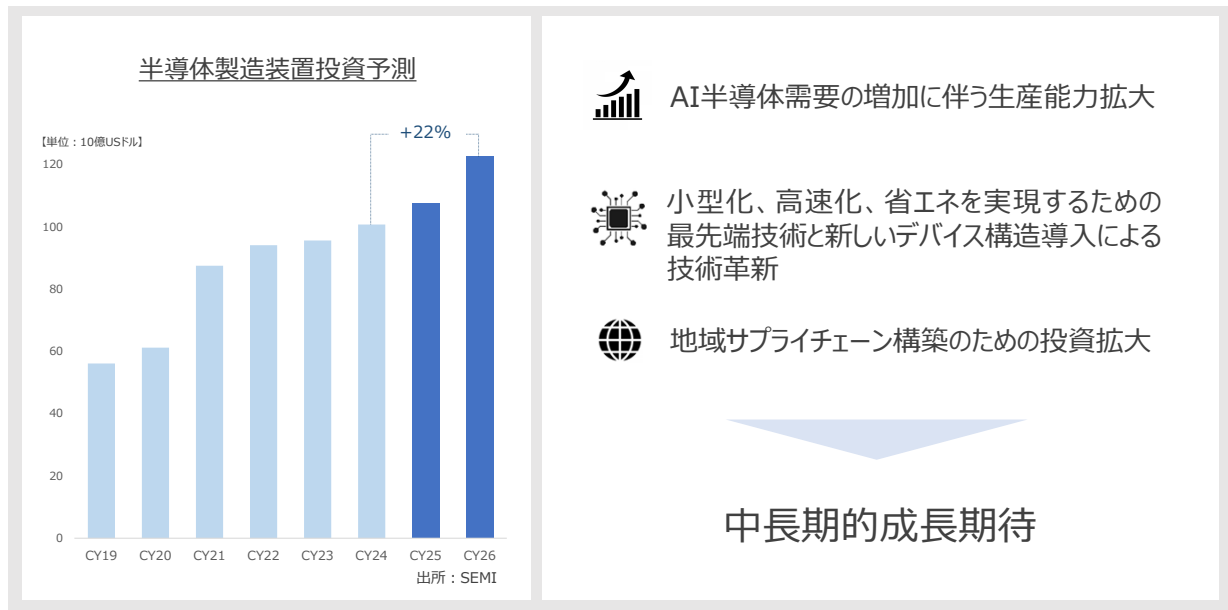
●バッテリー関連

次世代バッテリーの車載への採用タイミングに遅延が見られ、一部の案件が来期にずれ込むなどしていますが、中長期的には成長すると考えております。

●コンポーネントほか

半導体関連投資の回復等で、安定基盤ビジネスとして堅調に推移すると見込みであり、中でも、AIサーバー等の冷却システム用リークテスト装置の新規用途がでてきていることや、研究開発用表面分析装置が、好調に推移していく見通しであります。

これらの今後の市場環境、投資動向のトレンドを確実に捉えながら、全体の受注拡大を目指してまいります。



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

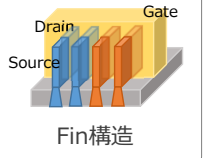
12

・半導体市場の見通し

AI半導体需要の増加に伴う生産能力の拡大、小型化・高速化・省エネ実現に向けた最先端技術と新たなデバイス構造導入による技術革新が進み、地域サプライチェーン構築に向けた投資の拡大も見込まれるなど、中長期的に成長していくことが期待できます。

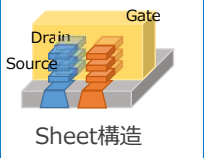
ロジック・デバイス構造の変化

3nm世代



Fin構造

2nm世代
beyond



Sheet構造

**技術革新（微細化）に伴い、
先端ロジックのビジネス機会拡大**

- MHM（メタル・ハード・マスク）適用拡大
 - ・ 5nm・3nmプロセスの拡張
 - ・ EUV露光に加え、DUV露光でも適用拡大
 - ・ MHMの金属材料であるTiNを電極材料として適用
- 2nm世代進展に伴い、Fin構造からSheet構造へ移行
 - ・ 拡散工程のための新Hardmaskの拡大期待
 - ・ 裏面配線への適応
- 他金属工程等、重要顧客との共同開発によるPOR獲得件数拡大（セカンドベンダー期待）

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

13

・先端ロジック

5ナノ、3ナノの高稼働率に伴い、MHM（メタル・ハード・マスク）工程の増産投資が進んでいるほか、DUV露光向けでもMHMの適用が拡大しています。

また、MHMの金属材料であるチタンナイトライドを電極材料として適用する動きが見られるなど、実績のあるMHMの適用範囲は広がっています。

これらをしっかりと受注に結びつけることで、ロジック分野の成長を加速させます。


2ナノ世代への進展に伴っては、トランジスタがFin構造からSheet構造へと移行する中で、既にPORを獲得している拡散工程のための新しいハードマスクの受注拡大にも期待できます。

また、トランジスタ構造の変化により裏面配線の適用が見込まれることから、そこにもビジネス機会があると考えています。

これらのハードマスク用途の増加に加え、セカンドベンダーとしての期待に応えていくべく、顧客との共同開発を進め、さらなるPOR獲得を目指していきます。


繰り返しになりますが、潜在的な可能性を含め、ロジック分野は数多くのビジネスチャンスを秘めておりますので、引き続き注力してまいります。

先端メモリ
High Bandwidth Memory

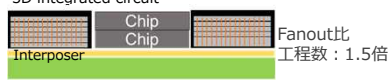


先端パッケージング

Chip on Interposer on Substrate

Now  Fanout比 工程数: 1.5倍

↓

Future  Fanout比 工程数: 1.5倍 + α

**AI半導体需要増加による
生産能力拡大・技術革新進展で成長**

先端メモリ

- ・ HBM需要拡大に伴う、従来DRAM（DDR5）の投資拡大
- ・ TiN MHM適用によるDRAM微細化進展
- 次世代NAND向け投資活発化
- 他金属工程等、重要顧客との共同開発によるPOR獲得件数拡大（セカンドベンダー期待）

先端パッケージング

- インターポーザ用デスカム処理装置の投資活発化
- 次世代先端パッケージング向けスパッタリング装置、デスカム・デスマリア処理装置、プラズマダイシング等の開発継続

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved | 14

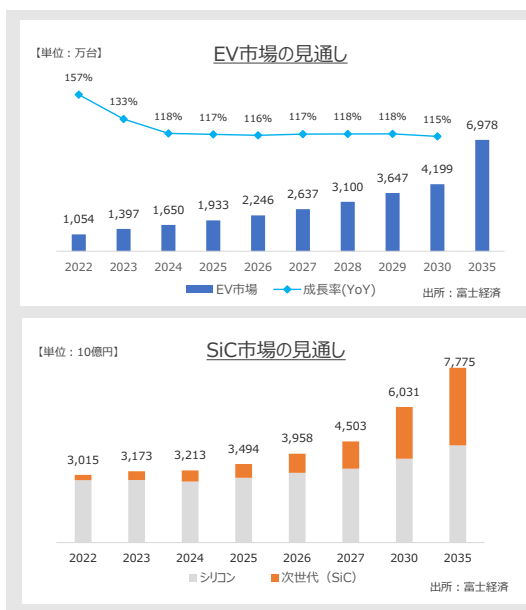
・先端メモリ・パッケージング

先ほどの通り生成AI関連ビジネスの活発化に伴い、需要の拡大が続くと見込んでおります。




メモリにおいては、HBM構造でDRAMをつなぎ合わせる配線層工程が寄与することに加え、HBMを構成する従来DRAM（DDR5）への投資も期待できます。そして、DRAMの微細化が進んでいく中で、ロジックで実績のあるメタル・ハード・マスクの適用や、次世代NANDの投資にも期待しています。また、ロジックと同様にDRAM・NANDともに他の金属工程等の共同開発が進行中であり、POR獲得件数の拡大を目指してまいります。

・パッケージング

ファウンダリー向けインターポーザ用デスカム処理装置等の当期受注を100億円程度見込むなど年々拡大しており、投資の活発化が続いています。さらに、次世代の先端パッケージングに向けて、スパッタリング装置、デスカム・デスマリア処理装置、プラズマダイシング等の開発を推し進め、ビジネスを拡大していきます。



EV市場回復に伴い SiC市場は大きく成長

-  ウェハーサイズアップ（6→8inch）に伴い、日本・中国で販売拡大
-  高いシェアを有する日本:スパッタリング装置、中国:イオン注入装置をクロスセルで拡販
- 
 - ・プレーナ→トレンチ構造切替を機にSiC化合物エッチング装置を拡販
 - ・GaN化合物スパッタリング装置の市場投入 →将来の需要を取り込む

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

15

・パワーデバイス

もう暫くは弱含む状況が続くと思いますが、将来的なEV市場の回復に併せて、SiC市場も大きく成長すると見込んでおりますので、中長期的な期待感は今も変わっておりません。

引き続き、6インチから8インチへのウェハーサイズアップを契機とした販売拡大、高いシェアを有している日本市場でのスパッタリング装置、中国市場でのイオン注入装置のクロスセルを推進していきます。

そして、今後、SiCパワーデバイスの構造がプレーナからトレンチ構造に移行することで、SiC化合物に適したエッチング装置の拡販に期待しているほか、GaN化合物のスパッタリング装置を市場に投入しているため、これらの将来需要も取り込んでいくことを視野に入れています。

両面蒸着膜集電体の効果

- ① 安全性向上
- ② 小型軽量化
- ③ 部材コスト低減
- ④ GHG低減

サプライチェーン

当社
[蒸着巻取装置]

材料加工メーカー
[バッテリー部材]

バッテリーメーカー
[バッテリー]

EVメーカー
[電気自動車]

安全性向上・小型軽量化実現に向けたアルミ両面蒸着膜技術の普及により成長

- 現行モデルの生産安定化に向けた顧客フォローの継続による改善
- 生産性向上を目指すフィルム幅広化モデルの量産技術開発継続
- ・ 負極集電体の置き換えを目指す銅厚膜成膜の開発継続
 - ・ 次世代電池負極（リチウム）の開発継続

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

16

・バッテリー

安全性向上や小型軽量化を目的とした、従来の正極集電体であるアルミ箔からアルミの両面蒸着膜への置き換え投資が見込まれるため、中長期的な成長予測自体は変えておりません。これから車載への採用が進展するにつれて、バッテリー投資は本格化していくと見ております。

現在、現行モデルの生産安定化に向けた顧客フォローを行いつつ、市場シェアを確保すべく生産性の向上による差別化が図れるアルミ両面蒸着膜のフィルム幅を広げる量産技術開発を進めており、年内の受注獲得を見込んでいます。

そして、負極集電体の置き換えを目指した、銅の両面蒸着膜向け装置の開発及び、将来への取り組みとして、リチウムを用いた次世代電池負極の開発も継続して進めていきます。

半導体向け成膜装置の新モデル受注開始

従来モデルの特長を継承しつつ、データ収集・解析能力と拡張性を強化した次世代プラットフォーム「ENTRON-EXX」の受注開始

- 待機状態での消費電力**20%削減**
- クリーンルーム内での設置床面積**最大10%削減**
- リアルタイムでのデータ解析により生産性向上
- 迅速なモジュール追加が可能な設計により変化するニーズに柔軟に対応 ⇒移設改造納期**50%削減**

真空技術を通じて半導体産業の発展に貢献



トピックス

こちらは12月に発表させていただいた、半導体向け成膜装置の新モデル「ENTRON-EXX」です。

旧モデルとの特徴を比較しますと、待機状態での消費電力を20%削減できるほか、クリーンルーム内での設置床面積を最大で10%削減が可能となっております。

また、リアルタイムでのデータ解析による生産性向上が見込めることや、迅速なモジュール追加が可能な設計により変化するニーズに柔軟に対応できるため、移設改造納期を50%削減が可能です。

新しいプラットフォーム「ENTRON-EXX」は、データ収集・解析能力と拡張性を強化した次世代プラットフォームとなります。

Silicon Austria Labs GmbH (SAL) と連携 薄膜ニオブ酸リチウム (TFLN) の量産製造プロセス 向けプラズマエッチング技術を開発

TFLNは広帯域、低損失、高効率の特性を持つ次世代光デバイス材料であり、データ通信容量の需要に対応

SALは、光デバイス内部の光導波路を形成するためのプラズマエッチング装置「NLD-5700」を導入し、200mmプラットフォームでの材料統合とスケラビリティの向上を目指す

この協力により、技術革新を推進し、マイクロエレクトロニクスエコシステム全体に貢献



Silicon Austria Labs GmbH (SAL) は、マイクロシステム、センサーシステム、インテリジェント無線システム、パワーエレクトロニクス、組み込みシステムの分野で、一貫した研究成果と経済的影響を生み出すことで、アイデアを革新へとつなげています。



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

18

トピックス

シリコン・オーストリア・ラブスと連携し、薄膜ニオブ酸リチウム (TFLN) の量産製造プロセス向けプラズマエッチング技術を開発していきます。

シリコン・オーストリア・ラブスは、光デバイス内部の光導波路を形成するためのプラズマエッチング装置「NLD-5700」を導入し、200mmプラットフォームでの材料統合とスケラビリティの向上を目指します。

これらの新しい装置とともに、今後のビジネス拡大を目指してまいります。

AI 人工知能(AI) 電子部品 半導体

- 半導体
- 電子部品
- コンポーネント
- 材料

IoT 遠隔医療 ワクチン 無菌製剤

- 半導体
- 電子部品
- FPD
- 一般産業用
- コンポーネント
- 材料

データセンター データセンター パワーデバイス 半導体メモリ 電子部品 ロジック半導体

- 半導体
- 電子部品
- コンポーネント
- 材料

電動車 電動車 高性能バッテリー パワーデバイス 磁石 電子部品

- 半導体
- 電子部品
- FPD
- コンポーネント
- 材料

真空遮断器 熱交換機

- 一般産業用
- コンポーネント

風力発電 風力発電 パワーデバイス 発電用高性能磁石

- 半導体
- 電子部品
- 一般産業用
- コンポーネント
- 材料

スマートホーム スマートホーム 半導体 電子部品 ディスプレイ

- 半導体
- 電子部品
- FPD
- コンポーネント
- 材料

フリーストライサプリメント フリーストライ サプリメント

- 一般産業用
- コンポーネント

ドローン ドローン スマート農業 半導体 電子部品 バッテリー

- 半導体
- 電子部品
- コンポーネント
- 材料

太陽電池 太陽電池発電設備 制御用パワーデバイス

- 電子部品
- FPD
- コンポーネント
- 材料



ULVAC